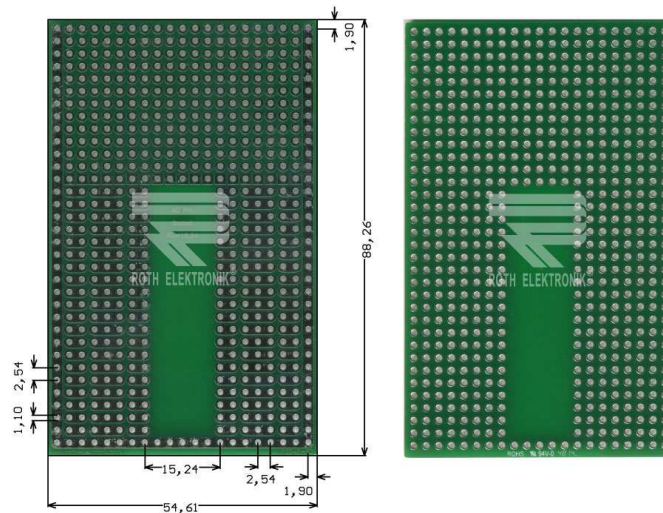


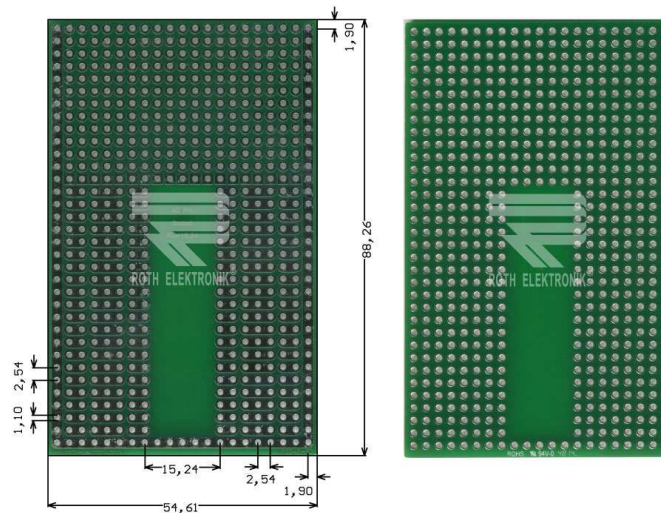
RE945-S3

- Solderable Bread Board 40-Pin-Socket
- Epoxy fibre-glass 1.50 mm
- Single-sided 35 µm Cu
- Hot air leveling (HAL leadfree)
- Solder stop mask
- Adaption circuit board for 40-Pin-Sockets with a distance of 15.24 mm
- Hole spacing 2.54 mm
- 20 three-hole-pads and 2 x 20 two-hole-pads on each side
- U-shape potential strip
- 12 x 16 solder pads Ø 2.20 mm with 2,54 mm grid
- Size 54.61 x 88.26 mm



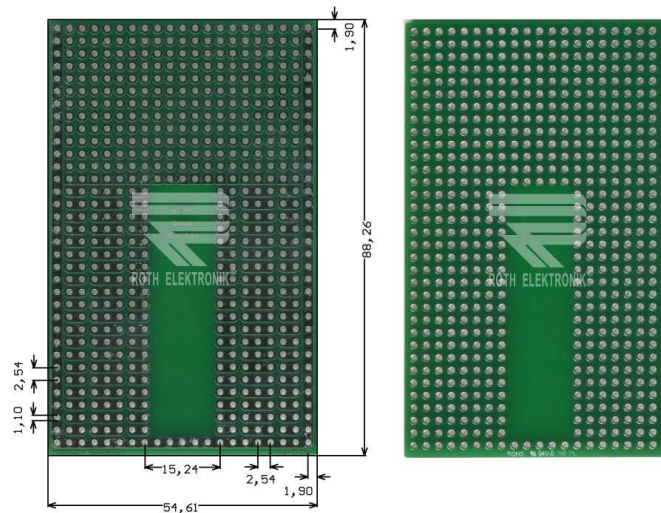
RE945-S3

- Lötbares Bread Board für 40-Pin-Sockel
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Heißverzinkt
- Lötstopplack
- Adapter für 40-Pin-Sockel im Abstand 15,24 mm
- Raster 2,54 mm
- Je Seite 20 3-Loch-Lötinseln und 2 x 20 2-Loch-Lötinseln
- U-förmige Masseleitung
- Experimentierfeld im Raster 2,54 mm mit 12 x 16 Lötinseln Ø 2,20 mm
- Größe 54,61 x 88,26 mm



RE945-S3

- Carte d'expérimentation soudable Prise à 40 broches
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Simple face 35 µm Cu
- Étamée à air chaud (HAL sans plomb)
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour prises à 40 broches avec un écart de 15.24 mm
- Pas 2.54 mm
- 20 îlots à trois trous and 2 x 20 îlots à deux trous de chaque côté
- Bande de potentiel en forme de U
- 12 x 16 îlots de brasage Ø 2.20 mm avec 2,54 mm grid
- Dimensions 54.61 x 88.26 mm



RE945-S3

- Bread Board soldable para zócalo de 40 pins
- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por un lado 35 µm de Cu
- Estañado en caliente
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Adaptador para zócalo de 40 pins a una distancia de 15,24 mm
- Espacio entre orificios 2,54 mm
- 20 nodos de soldadura de 3 orificios por lado y 2 x 20 nodos de soldadura de 2 orificios
- Cable conductor en forma de U
- Zona de experimentación en el espacio entre orificios de 2,54 mm con 12 x 16 nodos de soldadura de Ø 2,20 mm
- Tamaño 54,61 x 88,26 mm